|  |
| --- |
| [2024-2030年中国IC设计市场调查研究及发展前景趋势分析报告](https://www.20087.com/3/12/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html) |



#### [中国市场调研网](https://www.20087.com/)

[www.20087.com](https://www.20087.com/)

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | [2024-2030年中国IC设计市场调查研究及发展前景趋势分析报告](https://www.20087.com/3/12/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html) |
| 报告编号： | 2221123　　←电话咨询时，请说明该编号。 |
| 市场价： | 电子版：8500 元　　纸介＋电子版：8800 元 |
| 优惠价： | 电子版：7600 元　　纸介＋电子版：7900 元　　可提供增值税专用发票 |
| 咨询电话： | 400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099 |
| Email： | Kf@20087.com |
| 在线阅读： | [<https://www.20087.com/3/12/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html>](https://www.20087.com/2/95/ZhiNengXiWanJiShiChangQianJingYuCe.html) |
| 温馨提示： | 订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。 |

二、内容简介

　　集成电路（IC）设计行业是半导体产业的创新引擎，近年来随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的兴起，IC设计迎来了前所未有的发展机遇。先进制程技术的突破，如7nm、5nm乃至更小的节点，使得IC能够集成更多晶体管，实现更高性能和更低功耗。同时，EDA（Electronic Design Automation）工具的智能化，提高了设计效率和准确性。
　　未来，IC设计将更加注重异构集成和定制化。随着摩尔定律逼近物理极限，通过将不同类型的功能模块（如CPU、GPU、AI加速器）集成在同一芯片上，可以继续提升系统性能。同时，针对特定应用的专用芯片（ASIC）和FPGA（Field-Programmable Gate Array）将更加流行，以满足个性化和高效能计算的需求。
　　《[2024-2030年中国IC设计市场调查研究及发展前景趋势分析报告](https://www.20087.com/3/12/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html)》在多年IC设计行业研究结论的基础上，结合中国IC设计行业市场的发展现状，通过资深研究团队对IC设计市场各类资讯进行整理分析，并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库，对IC设计行业进行了全面、细致的调查研究。
　　市场调研网发布的[2024-2030年中国IC设计市场调查研究及发展前景趋势分析报告](https://www.20087.com/3/12/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html)可以帮助投资者准确把握IC设计行业的市场现状，为投资者进行投资作出IC设计行业前景预判，挖掘IC设计行业投资价值，同时提出IC设计行业投资策略、营销策略等方面的建议。

第一章 IC设计行业概述
　　第一节 IC设计行业特点
　　第二节 IC设计行业发展趋势

第二章 中国IC设计行业发展环境分析
　　第一节 经济环境分析
　　　　一、国民经济运行情况gdp
　　　　二、消费价格指数cpi、ppi
　　　　三、全国居民收入情况
　　　　四、恩格尔系数
　　　　五、工业发展形势
　　　　六、固定资产投资情况
　　　　七、财政收支状况
　　　　八、中国汇率调整
　　第二节 政策环境分析
　　　　一、行业政策影响分析
　　　　二、相关行业标准分析
　　第三节 IC设计行业社会环境分析
　　　　一、人口环境分析
　　　　二、教育环境分析
　　　　三、文化环境分析
　　　　四、生态环境分析
　　　　五、中国城镇化率
　　　　六、居民的各种消费观念和习惯
　　第四节 2024年中国IC设计行业技术环境分析

第三章 全球及中国IC设计市场
　　第一节 全球IC设计市场
　　第二节 中国台湾IC设计市场
　　第三节 中国大陆IC设计市场
　　　　一、中国IC设计市场概况
　　　　2024-2030年中国IC设计公司营收情况
　　　　从设计业销售变化情况来看，全行业销售预计为1945.98亿元，比的1518.52亿元增长28.15%，在全球集成电路设计业所占的比重再次大幅提高。
　　　　2017年我国芯片设计业的从业人员规模与的基本相同，略有增长，大约为14万人。因而得出人均产值139万元人民币。
　　　　2024-2030年中国不同方向IC设计的收入规模（单位：亿元）
　　　　截止，据统计，产品领域分布情况来看，在通信、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等8个领域中，有5个领域的企业数量增加，3个领域的企业数量下降。
　　　　从事通信芯片设计的企业从的241家增加到266家，销售额增长了30.7%，达到899.74亿元。
　　　　从事多媒体芯片设计的企业从去年的43家到增长72家，销售总额下降了0.63%，达到175.57亿元；
　　　　从事模拟芯片设计的企业数量从219家减少到180家，销售额增长了5.14%，达到68亿元。
　　　　从事功率器件设计的企业从77家增加到82家，销售额增长了155.14%，达到76.67亿元，为增长最快的产品领域；
　　　　从事消费类电子芯片设计的企业数量从上年的589家增加到610家，销售增长45.2%，达452.33亿元，继续保持了的快速增长势头。
　　　　从事智能卡芯片设计企业从上年的69家减少到62家，但销售总和上升了5.68%，达到139.15亿元。
　　　　从事计算机芯片设计的企业数量从去年的107家减少到85家，但销售提升了13.99%，达到128.28亿元。
　　　　IC设计企业，未来建议关注指纹识别芯片龙头企业汇顶科技、模拟IC设计公司圣邦股份、安防芯片设计的富瀚微等，这些公司研发实力强、创新能力强，有望着芯片国产化的东风伴随着国内市场一起成长。
　　　　二、中国手机IC市场
　　　　三、中国智能卡IC市场
　　　　四、中国电源管理芯片市场

第四章 基础类IC设计企业
　　第一节 上海贝岭（600171，shanghai belling co.， ltd.）
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第二节 无锡华润微电子
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、发展战略
　　第三节 华微电子（600360，jilin sino-mICroelectronICs co.， ltd.）
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第四节 晶门科技（，solomon system）
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第五节 北京君正集成电路股份有限公司（上市通过审核）
　　第六节 北京神州龙芯集成电路设计有限公司
　　第七节 苏州国芯科技有限公司

第五章 通讯类IC设计企业
　　第一节 国民技术
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第二节 锐迪科（rda mICroelectronICs，inc）
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第三节 海思
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第四节 展讯
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第五节 联芯科技有限公司
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略

第六章 多媒体IC设计企业
　　第一节 中星微电子
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第二节 珠海炬力
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第三节 士兰微
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第四节 上海泰景
　　第五节 深圳芯邦
　　第六节 上海格科微
　　第七节 北京海尔
　　第八节 杭州国芯

第七章 智能卡IC设计企业
　　第一节 远望谷（002161）
　　　　一、企业基本情况
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　四、企业偿债能力分析
　　　　五、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第二节 上海复旦微电子
　　第三节 大唐微电子
　　第四节 上海华虹
　　第五节 北京同方微电子有限公司

第八章 其他类型IC设计企业
　　第一节 欧比特
　　　　一、企业基本情况
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　四、企业偿债能力分析
　　　　五、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第二节 福星晓程（300139）
　　　　一、企业基本情况
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　四、企业偿债能力分析
　　　　五、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第三节 长电科技
　　　　一、企业基本情况
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　四、企业偿债能力分析
　　　　五、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第四节 东软载波
　　　　一、企业基本情况
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　四、企业偿债能力分析
　　　　五、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析

第九章 2018-2023年中国IC设计发展前景预测
　　第一节 行业发展趋势预测
　　第二节 未来企业竞争格局
　　第三节 行业资源整合趋势
　　第四节 产业链竞争态势发展预测

第十章 2018-2023年中国IC设计行业投资机会与风险预警
　　第一节 投资环境的分析与对策
　　第二节 投资机遇分析
　　第三节 投资风险分析
　　　　一、政策风险
　　　　二、经营风险
　　　　三、技术风险
　　　　四、进入退出风险
　　第四节 投资策略与建议
　　　　一、企业资本结构选择
　　　　二、企业战略选择
　　　　三、投资区域选择
　　第五节 中智林:专家投资建议

图表目录
　　图表 IC 产业垂直分工演化过程
　　图表 IC设计在半导体产业链中的价值占比
　　图表 IC设计技术发展进程
　　图表 IC系统性能和集成度
　　图表 3c应用领域关键IC整合趋势
　　图表 人机接口关键半导体组件及主要供货商
　　图表 全球25大IC设计商
　　图表 2024-2030年中国台湾IC设计产业产值
　　图表 2024年中国台湾IC设计产业前10大厂商营收及成长率
　　图表 2024-2030年中国IC设计产值变化趋势图
　　图表 中国IC市场应用结构
　　图表 2024-2030年国内手机出货量
略……

了解《[2024-2030年中国IC设计市场调查研究及发展前景趋势分析报告](https://www.20087.com/3/12/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html)》，报告编号：2221123，

请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，

Email邮箱：Kf@20087.com

详细介绍：<https://www.20087.com/3/12/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html>

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！